

2021-2027年中国IC封装 行业分析与前景趋势报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国IC封装行业分析与前景趋势报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202104/215099.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

IC封装，就是指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国IC封装行业分析与前景趋势报告》共九章。首先介绍了IC封装相关概念及发展环境，接着分析了中国IC封装规模及消费需求，然后对中国IC封装市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国IC封装面临的机遇及发展前景。您若想对中国IC封装有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC封装产业相关概述

第一节 IC封装简介

第二节 IC封装类型简介

一、SOP封装

二、QFP与LQFP封装

三、FBGA

四、TEBGA

五、FC-BGA

六、WLCSP

第三节 明日之星——TSV封装

一、TSV简介

二、TSV与SoC

三、TSV产业与市场

第二章 世界IC封装运行状况分析

第一节 世界IC封装业运行环境分析

第二节 世界IC封装运行现状综述

一、IC封装特点分析

二、IC封装业技术分析

三、IC封装业动态分析

第三节 世界IC封装重点企业运行分析

一、英特尔 (Intel)

二、IBM

三、超微

四、英飞凌 (Infineon)

第四节 2021-2027年世界IC封装业趋势探析

第三章 中国IC封装行业市场发展环境解析

第一节 中国宏观经济环境分析

一、中国GDP分析

二、中国汇率调整分析

三、中国工业发展形势分析

第二节 中国IC封装市场政策环境分析

一、电子产业振兴规划解读

二、内需拉动业，IC业政策与整合是关键

三、相关行业政策及对IC封装产业的影响

第三节 中国IC封装市场技术环境分析

一、高端IC封装技术

二、中高端IC封装技术有所突破

三、IC封装基板技术分析

第四章 2016-2019年中国IC封装相关所属行业数据监测分析

第一节 2016-2019年中国集成电路制造所属行业发展分析

一、2016年中国集成电路制造所属行业发展概况

二、2017年中国集成电路制造所属行业发展概况

三、2019年中国集成电路制造所属行业发展概况

第二节 2016-2019年中国集成电路制造所属行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、资产规模增长分析

三、销售规模增长分析

四、利润规模增长分析

第三节 2016-2019年中国集成电路制造所属行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、资产规模结构分析

三、销售规模结构分析

四、利润规模结构分析

第四节 2016-2019年中国集成电路制造所属行业成本费用分析

一、销售成本统计

二、主要费用统计

第五节 2016-2019年中国集成电路制造所属行业运营效益分析

一、偿债能力分析

二、盈利能力分析

三、运营能力分析

第五章 中国IC封装产业运行新形势透析

第一节 中国IC封装产业运行综述

一、大陆IC封装企业的分布及其特点

二、IC封装测试业外资独占鳌头

三、IC封装向高端技术迈一步

四、形成封装及自主品牌终端产业链

第二节 中国IC封装产业变局分析

一、IC封装业稳步发展，但产值比重有所下降

二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈

三、封装技术更新加快，国内水平显著提高

第三节 中国IC封装业面临的挑战分析

一、低档产品封装产能过剩,高端产品的封装刚刚起步

二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战

三、我国IC的相关行业配套能力差,也对封装业造成不利影响

四、技术相对滞后

五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足

第四节 对发展我国IC封装业的思考

第六章 中国IC封装细分市场运行分析

第一节 手机IC先进封装市场

第二节 手机基频封装

一、手机基频产业

二、手机基频封装

第三节 智能手机处理器产业与封装

第四节 手机射频IC

一、手机射频IC市场

二、手机射频IC产业

三、4G时代手机射频IC封装

第五节 PC领域先进封装

一、DRAM产业近况

二、DRAM封装

三、NAND闪存产业现状

四、NAND闪存封装发展

五、CPU GPU和南北桥芯片组

第七章 中国封装用材料运行分析

第一节 金线

第二节 IC载板

第八章 中国封装产业重点企业运行分析

第一节 长电科技

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第二节 南通富士通微电子有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第三节 安靠封装测试（上海）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第四节 上海纪元微科电子有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第五节 沛顿科技（深圳）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第六节 浙江华越芯装电子股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业经营状况分析

三、企业竞争优势分析

四、企业发展战略分析

第九章 2021-2027年中国IC封装业前景预测与投资战略分析

第一节 2021-2027年中国IC封装业前景预测

第二节 2021-2027年中国IC封装投资战略分析

一、IC封装业投资特性

二、IC封装业投资机会与风险预测

三、外资加大中国市场投资影响分析

四、投资建议

图表目录：

图表：2016-2019年集成电路制造行业企业数量增长趋势图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业亏损企业数量及亏损面情况变化图

图表：2016-2019年集成电路制造行业累计从业人数及增长情况对比图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业销售收入及增长趋势图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业毛利率变化趋势图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业利润总额及增长趋势图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业总资产利润率变化图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业总资产及增长趋势图

图表：2016-2019年中国集成电路制造行业亏损企业对比图

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202104/215099.html>